



单组分可固化导热储热凝胶

SY-SGP141

产品规格书

版本:A-c

❖ 产品介绍

SGP141单组分可固化导热储热凝胶是指有机硅树脂利用特殊的配方及工艺制成的具有高储热性能、可固化的特殊界面填充材料。在相对较低的压力下便实现良好的储热和导热能力，同时具有良好的润湿性，可以覆盖住微观不平整的表面从而储存元器件散发的热量，降低器件整体温度，有效控制体感温度。

❖ 产品规格

- 注射器： 30cc； 100cc； 300cc

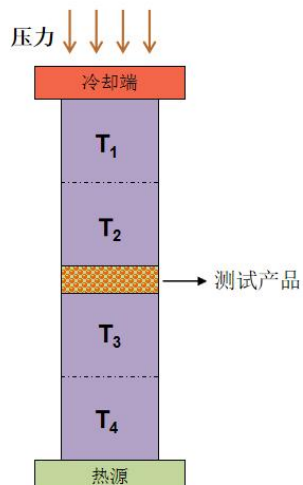
❖ 产品性能

- 良好的导热率，高焓值；
- 变形力极低，高度顺应性，良好的润湿性；
- 可塑性强，适合点胶工艺；
- 可固化成型，利于返工且可靠性佳。

❖ 典型特性

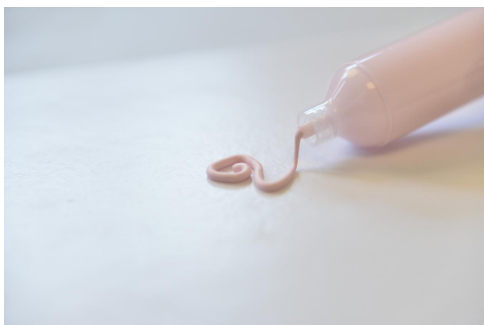
特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	目测
固化时间	> 72h (@25℃) <10h (@50℃) <4h (@85℃)	/
比重 (g/cm ³)	1.0	ASTM D792
硬度@25℃ (Shore OO)	75	ASTM D2240
焓值 (J/g)	140	ASTM D3418
相转变温度 (℃)	45	ASTM D3418
导热系数 (W/m·k)	0.2	ASTM D5470
体积电阻率 (Ω·cm)	1.0×10 ¹³	ASTM D257
耐压强度@1mm (kV/mm)	10.0	ASTM D149
介电常数@1MHz	2.9	ASTM D150
介电损耗@1MHz	0.0036	ASTM D150
长期使用温度范围 (℃)	-40~125	Saintyoo TM

□ 导热系数测试方法



❖ 产品应用

该产品广泛用于手机通讯设备、台式机、便携式电脑和服务器的LED照明设备、印刷电路板组件，外壳连接、光纤通讯设备、车用电子产品、军用电子设备等电子产品的发热器件与散热铝片或机壳间填充及热传导等等。



❖ 保质期及储存条件

- 保质期：6个月
- 储存条件：0℃以下包装储存
- 使用前，建议在室温下回温1.5小时
- 回温后，在室温条件下，建议48小时内用完
- 影响固化时间条件：温度，密封性

特别声明：建议客户在正式使用本产品之前先做应用性试验评估。由于产品实际应用的多样性，本公司不承担特定条件下使用我司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任，用户在使用产品过程遇到问题，可联系我公司售后服务部，我们将竭力为您提供帮助。